

澜起科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：澜起科技

证券代码：688008

编号：2026-005

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（券商策略会）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>Aberdeen Investments Antipodes Partners Ltd Aspen Aspoon Capital Ltd 3W Capital Balyasny Asset Management CoreView Capital Management Ltd Dymon Asia Capital HK Ltd Farallon Capital Asia (HK) Ltd Fenghe Fund Management Pte Ltd FIL Hong Kong Fullgoal Fund Management Co Ltd Gaoyi Asset Management Co Ltd GIC Goldman sachs Greenwoods Asset Management HK Ltd HSBC Global Asset Management Ltd INVESCO Asia Ltd Jain Global (Hong Kong) Ltd Janchor Partners Ltd Janus Henderson Investors Kadensa Capital Ltd</p>

<p>Kuwait Investment Office</p> <p>Lake Bleu Capital (Hong Kong) Ltd</p> <p>Marshall Wace Asia Ltd</p> <p>Millennium Partners</p> <p>Mirae Asset Global Investment (HK) Ltd</p> <p>Morgan Stanley Investment Management</p> <p>My.Alpha Management HK Advisors Ltd</p> <p>Nomura Asset Management Hong Kong Ltd</p> <p>North Rock Capital Management (HK) Ltd</p> <p>Pictet Asset Management</p> <p>Pinpoint Asset Management Ltd</p> <p>Pleiad Investment Advisors Ltd</p> <p>Point72 Asset Management</p> <p>Polymer Capital Management</p> <p>Principal Asset Management Co (Asia) Ltd</p> <p>Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd</p> <p>Robeco International</p> <p>Sands Capital Management LLC</p> <p>Schonfeld Strategic Advisors (Singapore) Pte. Ltd.</p> <p>Schroders Plc</p> <p>Springs Capital (Beijing) Investment Management Ltd</p> <p>Stonelake Asset Management (Hong Kong) Ltd</p> <p>Tairen Capital Ltd</p> <p>Teng Yue Partners</p> <p>Tenucia</p> <p>UBS Global Asset Management</p> <p>UG Investment Advisers Ltd</p> <p>Wetrust</p> <p>WT Capital Management</p>
--

	泰康资产管理有限公司 华泰证券股份有限公司
时间	2026年5月18日~5月21日
地点	公司会议室、券商策略会现场
出席人员	董事会秘书傅晓女士等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、交流的主要问题及答复</p> <p>问题1：最近CXL内存池化被业界广泛关注，请问CXL2.0到现在的3.x，主要增加了哪些功能？为什么说CXL3.0能够更好的支持内存池化？</p> <p>答复：CXL 2.0首度支持内存池化，但限于在单台交换机下的内存池化；CXL 3.0引入 Fabric 多级交换架构，可实现机架级全局池化，并新增多主机共享内存（Shared Memory）与动态容量分配（DCD）能力，使内存资源真正可全局灵活共享，对数据中心解耦内存有更实质意义。</p> <p>根据公开资料，未来主流服务器CPU平台对CXL 3.0的支持将更为普及，这不仅扩展了内存池化的物理边界，更有望进一步激活其深层应用潜力。</p> <p>问题2：服务器CPU市场中，不同架构的CPU、不同厂商的CPU出货占比变化对内存接口芯片市场会有什么影响？</p> <p>答复：内存接口芯片是JEDEC定义的标准化产品，可支持所有符合JEDEC标准的服务器CPU。根据公开资料，x86架构中，两家主流的CPU厂商新一代服务器CPU平台将支持DDR5 RDIMM及MRDIMM；Arm架构中，多家云服务提供商自研的Arm架构CPU以及Arm公司自研的AGI CPU均支持DDR5 RDIMM。上述CPU平台均支持使用内存接口芯片的内存模组。</p> <p>问题3：请问三年内在内存接口芯片领域是否会有新的玩家进入对现有竞争格局产生实质影响？</p> <p>答复：内存接口芯片领域的技术和商务门槛非常高。首先，该产品属于高性能、高速、非线性模拟及数模混合电路，产品研发难度大，需要长期积累相关的知识产权和设计研发经验。该产品的关键和基础专利已被行业龙头拥有，新进入者不仅需要长时间积累相关技术能力，还要能够不侵犯他人专利。</p> <p>其次，新进入者还需及时获得JEDEC相关标准的最新进展，并且在产品开发</p>

早期就要和主流CPU及内存厂商进行密切的技术交流。

最后，产品研发出来之后还需要经过主流CPU、内存模组和系统厂商严格的测试、验证，才能开始客户导入。新进入者面对的下游客户和合作伙伴都是行业龙头公司，商业准入门槛非常高。

综上，该产品的研发及验证导入周期冗长，新进入者如果现在进场研发目前行业龙头已认证完毕的子代产品，假设其最终能够完成客户导入，相关产品也已进入生命周期尾声。所以，即便有新进入者从现在开始布局，也很难在中短期内对竞争格局产生实质影响。

问题4：公司的内存接口芯片是否有供给国内存储厂商？国内存储厂商未来份额提升对公司有哪些影响？

答复：公司的内存接口芯片基于开放的行业国际标准开发，公司与国内外主流的内存模组厂商均保持良好的合作关系。

问题5：目前，公司DDR5内存接口芯片子代迭代的进度如何？

答复：今年第一季度，随着DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5 RCD芯片出货量显著增加，其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升。在新子代研发方面，公司已完成DDR5 第五子代RCD芯片量产版本的研发，正在开展DDR5第六子代RCD芯片的工程研发。

公司是DDR5 RCD芯片国际标准的牵头制定者，同时，我们的产品一直以来保持较高的质量水平以及稳定性和可靠性，使得公司在DDR5世代的竞争中持续保持全球领先地位。

问题6：公司自研SerDes技术主要基于哪些考量？

答复：高速SerDes技术是公司核心技术之一，它是高速互连芯片领域的关键底层技术，依托这项技术，我们已经成功开发出分别采用32GT/s和64GT/s的PCIe 5.0和6.0 Retimer芯片，目前128GT/s的SerDes技术也在研发中，未来将应用于我们的PCIe 7.0 Retimer芯片。

这项技术的重要性体现在以下几点：一方面，它将支撑Retimer芯片未来的持续迭代；另一方面，它也是我们在研PCIe Switch芯片的核心基础技术；同时，我们计划布局的以太网和光互连领域也需要用到SerDes技术，尽管以太网协议和

PCIe协议存在差异，但两者在高速互联的底层技术上是相通的。SerDes技术的成功研发，为我们拓展至更广的高速互连领域、完善产品布局，筑牢了技术根基。

问题7：AI agent快速发展的背景下，服务器CPU市场会产生哪些变化，对公司相关内存互连芯片又有哪些影响？

答复：未来内存互连芯片市场增长的直接驱动因素包括内存模组数量的增长以及内存互连芯片价值量增加。具体体现在以下四个方面：

第一，CPU在AI服务器用量增加将推动内存模组需求增长。根据行业分析，随着AI推理及Agent应用的快速发展，AI工作负载正在从训练端大规模向推理端及智能体迁移，这一转变对系统的逻辑判断、任务调度与实时交互能力提出了更高的要求，使得CPU的通用计算架构价值凸显，在AI系统中的重要性正在加强，因此，AI服务器中CPU与GPU的配置比例预计将持续提升。随着AI服务器中CPU占比的提升，内存模组数量将随之增长；同时，典型AI服务器内单颗CPU配置的内存模组用量，通常是通用服务器的2倍左右。因此，CPU在AI服务器用量增加将推动内存模组需求增长及内存互连芯片市场规模。

第二，CPU支持内存通道数增加将提升搭配内存模组数量。当前主流服务器CPU平台支持的内存通道数为8或12个，新一代CPU支持的内存通道数或将增加至16个，内存通道数增加意味着每个CPU最多可搭配的内存模组数量将相应增加。考虑到典型的AI服务器通常满插内存模组，因此，CPU内存通道数增加理论上将进一步提升内存模组需求及内存互连芯片市场规模。

第三，CPU多核化趋势将推动MRDIMM的需求。为满足AI、大数据等应用对算力与数据吞吐的迫切需求，服务器CPU的核心数量快速增加，这对内存系统带宽提出了更高的要求。MRDIMM以其带宽更高和更优的综合性能，正在成为产业重要的技术方向。未来随着支持第二代MRDIMM的CPU上市，MRDIMM的渗透率有望进一步提升，从而直接带动MRCD/MDB芯片需求增长。由于MRDIMM中“1颗MRCD+10颗MDB套片”的价值量远高于RDIMM中一颗RCD芯片的价值量，因此，MRDIMM需求增长将有助于内存互连芯片市场进一步扩容。

第四，从长期来看，DDR6内存模组或将需要更多、更复杂的内存互连芯片。JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，主流趋势是：DDR6内存模组将配置数量更多、设计更复杂的内存互连芯片。因此，DDR6内存互连芯片市场规模或将进一步增长。

总结而言，AI从训练向推理迁移，以及Agent等新应用的爆发，对全球内存

互连芯片市场扩容具有积极影响。我们凭借在DDR5子代迭代的领先优势，以及对DDR6等前沿技术的率先布局，将持续受益于这一产业趋势。

问题8：请问如何理解第二子代MRCD/MDB芯片未来的需求和竞争格局？

答复：MRDIMM是JEDEC制定的服务器高带宽内存模组标准，主要用于满足CPU多核化趋势下AI和高性能计算应用对内存带宽日益增长的迫切需求。

MRDIMM目前仍处于第二子代产品规模试用阶段，行业预期未来两到三年将从规模应用起步，进入快速爬升阶段，推动其发展因素主要有三点：

第一，从技术演进看，MRDIMM性能持续领先。第二子代MRDIMM的数据传输速率为12800MT/s，相比第一子代产品（支持速率8800MT/s）提升45%，是当前主流第三子代RDIMM（支持速率6400MT/s）的两倍，可有效缓解AI推理等应用场景的内存带宽瓶颈，而第三子代MRDIMM支持速率将达到16000MT/s，再次实现性能跃升。

第二，从产业生态看，CPU支持逐步成熟。预计从2026年下半年至2027年，将有更多的服务器CPU平台支持第二子代MRDIMM。CPU平台的广泛支持是MRDIMM在数据中心规模部署的基础，其产业生态将进一步完善。

第三，从需求驱动看，AI推理与Agent等应用有望为MRDIMM带来结构性、长期的机遇。此类应用会产生海量的KV Cache，对内存带宽提出更高要求。MRDIMM的高带宽特性，能以更优的总体拥有成本满足相关应用的需求。近期，随着RDIMM价格的快速上涨，进一步凸显了MRDIMM的性价比优势，有利于MRDIMM在下游的推广。

因此，随着MRDIMM行业渗透率的提升，MRCD/MDB芯片市场规模也将快速增长。

作为MDB芯片国际标准的牵头制定者，公司引领相关技术的创新并保持行业领先地位。2025年1月，我们推出了第二子代MRCD/MDB芯片，在最近的两个季度实现出货量显著提升，我们的产品凭借优异的性能和出色的稳定性获得全球主要内存模组厂商的认可，为后续产业放量奠定了基础。此外，我们计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发，以持续巩固技术领先地位。

问题9：公司PCIe Retimer目前的迭代进度如何？PCIe 6.0 Retimer预计什么时候开始规模上量？公司如何看待PCIe互连领域未来的竞争格局？

答复：公司的PCIe Retimer芯片基于行业开放标准研发，面向全球市场销售。目

	<p>前，公司PCIe Retimer芯片的出货以Gen 5产品为主。在国内市场中，依托优异的产品性能和本土服务支持的双重优势，澜起的PCIe Retimer芯片更受客户青睐。展望未来，随着国内外CSP厂商继续加大在AI领域的资本开支，叠加国产算力卡在国内市场的进一步应用，预计PCIe Retimer芯片需求将持续提升。</p> <p>公司于2025年1月推出PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片并向客户送样，目前正在积极配合客户测试验证。由于支持PCIe 6.0的服务器CPU尚未进入规模量产阶段，相关Retimer芯片仍处于产业导入期，行业预期2027年PCIe 6.0 Retimer芯片将进入正式的规模应用阶段。此外，我们于今年1月发布了PCIe 6.x/CXL 3.x 的AEC解决方案。目前我们正在积极推进PCIe 7.0 Retimer芯片的研发，计划今年完成工程样片的流片。</p> <p>根据行业分析，PCIe互连芯片未来市场规模将持续增长。我们认为，未来市场份额的获取将取决于扎实的技术储备、可靠的产品交付以及准确把握市场导入时机的能力。对公司而言，关键是持续做好产品的研发和技术迭代。随着PCIe Retimer芯片的代际升级，以及未来PCIe Switch芯片的推出，我们希望凭借核心技术优势及逐步完善的产品组合，在未来的市场竞争中持续提升份额。</p>
是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无